



东莞市创慧电子有限公司

物料规格书

客户名	立创	送样日期	
物料名称	固态铝电解电容器	客户料号	
物料编码	RAS331M250E120R1Z00ZZ	物料品牌	CH
物料规格	330 μ F/25V	物料尺寸	6.3X12
备注			

创慧确认			客户确认
经办	审核	批准	
曾冰虹	石彬	刘劲松	

系列：RAS

物料编码	规格	尺寸
RAS331M250E120R1Z00ZZ	330 μ F/25V	6.3X12

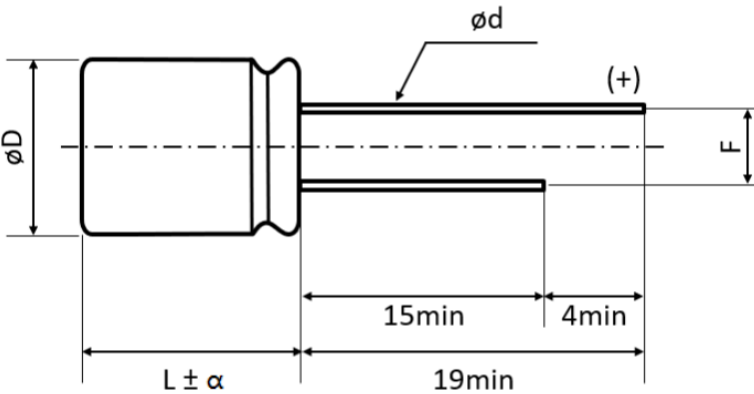
1. 工作温度范围：

-55~125℃

2. 电气特性：

额定工作电压(V)	浪涌电压(V)	标称容量(μ F)	容量范围(%) 120Hz 20℃	最大损耗 120Hz 20℃	最大漏电流(μ A) 2min. 20℃	最大允许纹波 电流(mArms) 100kHz 125℃	阻抗(ESR) (m Ω) 100kHz 20℃
25	28.8	330	±20%	0.1	200	1200	22

3. 尺寸：



单位(mm)

D(± 0.50)mm	L (mm)	α (mm)	F(± 0.50)mm	φ d(± 0.05)mm
6.3	12	1.00	2.5	0.5

4. 捺印标识：

以下印字为：

	①：负极标识 Logo ②：系列 ③：标称容量 ④：额定电压
	⑤：周期 Date code “5”：2025年 公历年代码 Digit of Christian year “20”：第20周 周代码 Month

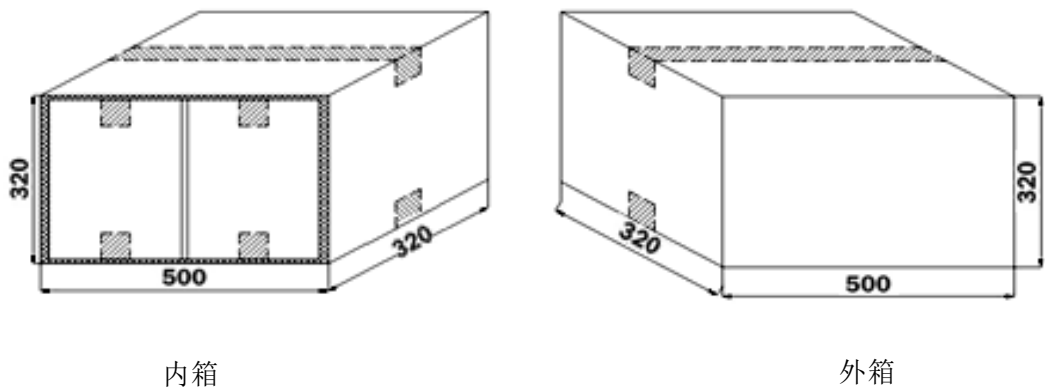
5. 频率系数：（频率系数不适用于寿命验证, 仅供参考）

频率HZ	120≤f<1K	1K≤f10K	10K≤f<100K	100K≤f<500K
系数	0.05	0.3	0.7	1.0

6. 试验项目：

序号	项目	标准			试验方法		
1	高温负荷寿命	漏电流		≤表1 规定值	电容在正常条件下可工作 2000 H		
		容量变化		在初始值的±20%以内			
		损耗		≤150% 表1 规定值			
		外观		≤无明显异常			
		ESR		≤150%			
2	高温贮存	漏电流		≤200%表1 规定值	试验温度：125±2℃ 不施加电压 试验时间:1000 hours		
		容量变化		在初始值的±20%以内			
		损耗		≤150%表1 规定值			
		外观		≤无明显异常			
		ESR		≤150%			
3	引线抗拉及抗弯强度	CP线线径	抗拉强度	抗弯强度	保持时间： 直线拉伸：1~5 sec 弯曲拉伸：30±5 sec		
		0.5mm（含）以下	5N（0.51KG）	2.5N(0.25KG)			
		0.6~0.8mm	10N(1.02KG)	5N(0.51KG)			
4	温度特性	要求			阶段	温度℃	测试项目 (120HZ)
		容量变化在初始值±20%内			1	20±2	CAP/DF/ESR
		损失角不超过规定值			2	最低使用温度±3	ESR
		ESR不超过规定值			3	20±2	CAP/DF
					4	最高使用温度±3	
			5	20±2			
5	涌浪电压	项目	标准		试验温度：15~35℃ 试验电压：见第 2 页浪涌电压规定值 充电30±5秒，频率为6±0.5 秒， 放电5分30秒，周期为1000次。		
		漏电流		≤ 初始规定值			
		容量变化		在初始值的±20%以内			
		损耗		≤150%表1 规定值			
		外观		≤无明显异常			
		ESR		≤150%			
6	抗振试验	容量	参数稳定		频率：10~55Hz 振幅：0.75mm(全距1.5mm) 方向和持续时间： X, Y, Z轴方向各振动2小时。		
		容量变化	≤ 在初始值的±5%以内				
		外观	无明显异常				
7	可焊性	试验后端子浸渍位置至少95%面积包盖了新锡。			焊料：约25%松香/乙醇溶液，焊料Sn-Ag-Cu 温度：243±5℃ 时间：2±0.5秒		
8	耐焊接热	漏电流	≤不超过规定值		焊接温度： 260±5℃ 焊接时间： 10±1sec.		
		容量变化	在初始值的±5%内				
		损耗	≤不超过规定值				
		外观	≤无明显异常				
9	稳态湿热试验	漏电流	≤不超过规定值		试验温度 :60±2℃ 湿度：90~95% 试验时间：1000 ± 48 hours 在上述试验以后，恢复到正常温度再测试。		
		容量变化	在初始值的±20%以内				
		损耗	≤不超过规定值1.5倍				
		外观	≤无明显异常				
注意事项：							
1. 以上数据仅供参考，使用寿命长短取决于工作的环境温度、连续工作时间、电流大小等许多其他因素，实际结果可能有所不同。							

7. 包装箱标准（长脚品）：



8. MOQ 最小起订量：

尺寸	切脚	长脚	编带
Φ4-5.5	1000	1000	2000
Φ6.3	1000	1000	1500
Φ8	500	500	1000
10X10 10X12	500	500	600
10X15 10X20	250	250	600
Φ13	100	100	400

9. 焊接：

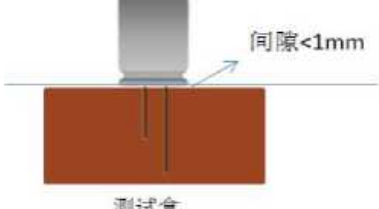
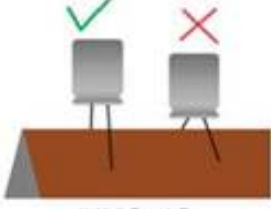
9-1 用烙铁焊接

烙铁温度：270～350℃
焊接时间：3秒内

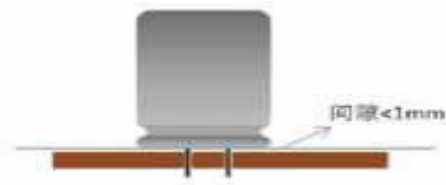
9-2 回流焊（仅用于贴片SMD产品）

预热：PCB板表面温度120℃±5℃
焊接温度260℃±5℃
时间：10sec

10. 特性测试注意事项：

		
测试前保持引脚垂直平行不能扭动、拉扯电容引脚测试。	容量/损失角/ESR值时，测试点需在引线根部。测试LC时，须保持引脚水平	不能让电容引脚呈八字形分开。

11. 安装注意事项:



11-1 对于表面贴装型电容器, 按照目录或产品规范设计PCB板;

11-2 对于插件型电容器, PCB板上的端子孔应与电容的端子间距相匹配;

11-3 检查极性后安装;

11-4 不要对引线端子和电容器本身施加过大的外力。

12. 印刷电路板焊接后的清洗要求:

为了保护塑料套管、印刷标志及封口材料不被破坏, 电容器不能用卤化物或类似溶剂作为电容器清洗用; 建议使用的清洗溶剂为: 甲醇、乙丙醇、石油醚、丙醇和一般的清洗剂;

- ① 超声波清洗时间请控制在5分钟以内, 清洗剂温度控制在60℃以下;
- ② 必须防止污染;
- ③ 远离清洁剂, 请不要储存在密封的容器中;
- ④ 干燥用的热空气温度应低于电容最大使用温度。